



2026年3月27日

各 位

会 社 名 三 菱 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 執 行 役 社 長 漆 間 啓
(コード番号 6503 東証プライム市場)
問 合 せ 先 広 報 部 長 山 崎 江 津 子
(TEL 03-3218-2111)

三菱電機のパワーデバイス事業、ロームと東芝デバイス&ストレージの半導体事業との事業・経営統合に関する協議開始に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ

三菱電機株式会社（以下、「当社」）は、ローム株式会社（以下、「ローム」）、株式会社東芝（以下、「東芝」）、日本産業パートナーズ株式会社（以下、「JIP」）及び TBJ ホールディングス株式会社（以下、「TBJ HD」、JIP と併せて「JIP ら」と表記）との間で、当社のパワーデバイス事業、ロームの半導体事業及び東芝の子会社である東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下、「東芝デバイス&ストレージ」）の半導体事業（以下、「本対象事業（東芝）」）についての事業・経営統合（以下、「本件」）に関する協議開始に向けた基本合意書を本日締結いたしました。

ロームと本対象事業（東芝）との間の提携については、ロームが 2024 年 3 月 29 日付「東芝半導体事業との業務提携強化に向けた協議開始の提案について」にて公表した協議開始の提案から本日に至るまで、ローム、東芝及び JIP らの間で協議が続けられていましたが、これに当社が加わることになりました。

これら事業・経営を統合することによって、世界市場で競争し得る事業規模や技術基盤を実現し、もって、我が国の半導体事業として幅広い顧客層と広範な産業分野の発展に大きく貢献するものであり、統合事業体の事業価値の最大化を実現し得るものであるという考えから合意したものです。

当社の本件に関する協議・検討は、本日時点では、その緒に就いたばかりの状況であり、今後新たに開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。また、当社の 2026 年 3 月期連結業績に与える影響についても、今後の進展によって公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

なお、今後速やかに当事者間で本格的に協議を進める予定であり、最終契約書を締結した場合には、その内容について改めて開示する予定です。また、本件の実施は競争法その他の法令等に基づき必要なクリアランス・許認可等の取得が完了することが前提となります。

別紙

1. ローム概要

(1)	名 称	ローム株式会社	
(2)	所 在 地	京都府京都市右京区西院溝崎町 21 番地	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 社長執行役員 東 克己	
(4)	事 業 内 容	各種電子部品の製造並びに販売	
(5)	資 本 金	86,969 百万円	
(6)	設 立 年 月 日	1958 年 9 月 17 日	
(7)	大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	18.39%
		公益財団法人ロームミュージックファンデーション	10.76%
		(株)デンソー	4.98%
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 [常任代理人:(株)みずほ銀行 決済営業部]	3.63%
		(株)京都銀行 [常任代理人:(株)日本カストディ銀行]	2.70%
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 [常任代理人:(株)みずほ銀行 決済営業部]	2.47%
		JP MORGAN CHASE BANK 380684 [常任 代理人:(株)みずほ銀行決済営業部]	1.64%
		HSBC HONG KONG—TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES [常任代理人:香港上海銀行東 京支店]	1.54%
		JP MORGAN CHASE BANK 385781 [常任代 理人:(株)みずほ銀行決済営業部]	1.19%
(8)	上場会社と当該会社の関係		
	資 本 関 係	記載すべき資本関係はありません。	
	人 的 関 係	該当事項はありません。	
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、製品又はサービス等の取引関係があります。	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。	

(注)「大株主及び持株比率(2025年9月30日現在)」は、ロームが2025年11月7日に提出した2026年3月期(第68期)に係る半期報告書の「大株主の状況」より引用しています。

2. 東芝デバイス&ストレージの概要

(1)	名 称	東芝デバイス&ストレージ株式会社	
(2)	所 在 地	神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 牛島 知巳	
(4)	事 業 内 容	半導体事業、ストレージプロダクツ事業	
(5)	資 本 金	10,000 百万円	
(6)	設 立 年 月 日	2017 年 7 月 1 日 (事業承継日)	
(7)	大株主及び持株比率	株式会社東芝	100.0%
(8)	上場会社と当該会社の関係		
	資 本 関 係	記載すべき資本関係はありません。	
	人 的 関 係	該当事項はありません。	
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、製品またはサービス等の取引関係があります。	
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。		

以 上